

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-022

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于 2025 年度提质增效重回报行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“立昂微”）结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容公告如下：

一、聚焦主营业务，提升公司竞争力

公司聚焦半导体硅片、半导体功率器件芯片和化合物半导体射频芯片三大主营业务，坚定长期主义发展理念，坚持与国家战略相向而行，依托产业链一体化优势，凭借完善的产品布局、扎实的技术积累、多样化的工艺平台以及规模化的生产能力，积极开拓市场，持续重点布局 BCD、CIS、重掺超低阻硅片、FRD、IGBT、VCSEL、pHEMT 等高附加值产品，不断丰富产品矩阵，持续推出新产品，在车载领域、工控领域、消费电子领域进一步提升了市场份额，2024 年实现主营业务收入 306,342 万元，同比增长 14.83%，驱动年度营收与出货量同步攀升至历史峰值。

2025 年，公司将继续聚焦主营业务，努力将半导体硅片、半导体功率器件芯片和化合物半导体射频芯片三大业务板块已建成的产能充分释放和消化，做到精准排产，精益管控，释放最大产能。通过订单全生命周期可视化管理与跨职能协同响应机制，贯通硅片、功率器件及射频芯片三大业务链的生产调度，实现客户全产品线覆盖。通过科学排产计划将存量产能转化为实际产出，为实现 2025 年度出货规模与价值最大化目标奠定基础。

二、坚持创新驱动，培育新质生产力

技术创新作为企业发展的战略引擎，是构建市场竞争壁垒的核心要素。公司始终以市场需求为创新导向，依托已有的技术创新平台，实施精准攻关，通过突破关键工艺、加速高附加值

产品研发，持续强化核心技术储备。2024 年，立昂微保持高强度的研发投入，全年研发费用为 2.9 亿元，同比增长 3.99%，占营业收入的比例为 9.39%。公司研发技术团队规模持续扩大，截至 2024 年末，公司技术研发人员为 563 人，较 2023 年末净增 29 人，占公司总人数的比例约为 16.14%。

在半导体硅片领域，成功开发 14 类具有差异化应用场景的新产品，其中开发 12 英寸新产品 93 款，进入量产的新规格产品 72 款；开发 8 英寸新产品 95 款，进入量产的新规格产品 68 款；开发 6 英寸新产品 118 款，进入量产的新产品 106 款；其中 12 英寸新品销售额占同尺寸产品营收 76%，8 英寸新品销售额占同尺寸产品营收 32%，6 英寸新品销售额占同尺寸产品营收 20%。公司攻克逻辑芯片及存储芯片用 12 英寸硅片制造技术，突破 12 英寸 P 型轻掺单晶、12 英寸闪存用单晶工艺和动态内存用单晶工艺，同步推进 8 英寸重掺砷低阻产品及 8 英寸重掺磷超低阻单晶工艺升级，产品已进入客户送样验证阶段。

在功率器件领域，聚焦高频化、高压化趋势，针对重点客户开发了新一代高频低损耗、高可靠性、高稳定性的 FRD 芯片等系列化产品，在新能源汽车和工业控制领域逐步实现国产替代，并通过技术创新和突破，自主设计代工开发平台，得到产业链主流厂商高度认可，彰显公司研发实力，为工业级通讯设备、电源管理芯片领域实现自主可控做出贡献。

在化合物半导体射频芯片领域，开发的 2D VCSEL 产品成功切入智能驾驶与机器人核心供应链，以高精度、低功耗、车规级可靠性为核心，形成了产品的核心竞争力，通过国内头部直接客户终端应用在机器人、车载激光雷达等领域，实现国产替代。pHEMT 则凭借全频段覆盖、超低噪声、高频功率的技术领先优势，突破 5G 毫米波与卫星通信“卡脖子”环节。

2025 年，公司将积极加大技术研发力度，积极培育新质生产力，在研发端聚焦新产品的开发，尽快实现产品突破。半导体硅片板块要依托重掺产品上的优势，加速推进 12 英寸轻掺产品验证进程与量产，实现 28nm 制程上有标志性的突破，同步强化重掺 Ph/As 超低阻产品开发以巩固细分领域优势地位；持续优化晶体生长与加工工艺，通过流程再造实现良率提升与生产效率倍增。功率器件业务启动车规级产品全维度对标工程，建立性能参数、质量标准与国际标杆的动态对齐机制，重点突破 FRD 结构优化、SJ MOS 导通损耗及 IGBT 开关特性等关键技术，加速车规级器件与沟槽电源产品的迭代开发。射频业务聚焦高频高增益技术路线，推进低成本工艺研发与材料国产化替代双轨并行，依托海宁基地产线条件，深化异质结外延工艺优化，着力破解 pHEMT 器件跨导线性度与功率附加效率的技术耦合难题，通过客户定制化开发实现新技术的量产转化，构建具有代际优势的射频产品矩阵。

三、坚持共享成果，积极回报投资者

公司自上市以来长期本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则进行利润分配，连续执行高比例现金分红政策。2021 年度至 2023 年度，公司分别派发现金红利 25,153.15 万元、28,427.80 万元、5,731.44 万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例分别为 41.32%、41.33%、87.16%。2024 年度，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 169,983,675.32 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 119,987,762.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2025 年，公司将结合已制定的《杭州立昂微电子股份有限公司市值管理制度》，引导上市公司价值理性合理回归内在价值，助力企业良性发展。公司将与广大投资者一起，实现公司战略、员工及股东互利共赢格局，共同开创价值共享、合作共赢的美好未来。

四、提升信披质量，加强规范化运作

公司致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，以投资者需求为导向，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的要求履行信息披露义务。2024 年度在合规信息披露的基础上，公司对 ESG 治理、提质增效重回报等工作进行自愿性信息披露，使投资者系统化了解公司所做的工作。公司充分利用业绩说明会、指定信息披露渠道、“上证 E 互动”平台等多种渠道，与投资者保持密切沟通。2025 年公司将进一步提升信息披露质量，优化与投资者沟通策略，提高上市公司透明度，与投资者进行充分的沟通与交流，实现公司与投资者之间更深层次的理解与信任，共谋公司发展新篇章。

公司严格遵守中国证监会及上海证券交易所有关规范运作的法律法规和监管要求，搭建公司治理体系，健全内部控制制度，2024 年度公司制定了公司舆情管理制度、会计师选聘制度、市值管理制度、可持续发展管理制度等内部管理制度，对提升上市公司合规治理有效性具有关键作用。2025 年公司将根据前述制定的制度，着力提升公司内部治理水平，同时及时跟踪法律法规的最新动态，持续优化公司内部治理制度，推动公司持续规范化运作，提升公司治理水平和规范运作能力，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、健全 ESG 体系，实现可持续发展

为了推进经济、社会、环境的可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，公司 2024 年度制定了《杭州立昂微电子股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》，明确公司将把可持续发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力

和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。公司已连续三年披露 ESG 报告。

在供应链责任维度，公司制定了《供应商管理程序》，明确供应商在职业健康安全、环境、有害物质管控等方面的要求，以及供应商社会责任评价准则，为全面衡量供应商社会责任表现确立规范。要求供应商全面遵守 SA 8000 社会责任标准的各项规定，充分尊重员工基本权益，致力于营造平等、公平的工作环境。与此同时持续践行本土化采购策略，优先选用国内厂商产品，推动本土半导体供应链生态的蓬勃发展。

在环境资源维度，公司以国家“双碳”目标为引领，秉持“坚持节约资源和环境保护”国策，奉行“改善环境、回报自然、杜绝污染、造福人类”的环境管理方针，积极探索环境友好型生产方式，公司所有生产主体均通过了 ISO 14001 环境管理体系认证。作为半导体材料研发、制造企业，公司产品的工艺流程需要消耗大量水资源，通过实施精细化管理模式与推进技术创新，持续减少单位产值所消耗的水资源量，从源头杜绝生产过程中的水资源浪费现象，增加中水回收利用，实现水资源利用效率的显著提升。

在劳动权益保障维度，公司实施全员标准化劳动合同管理体系，严格履行养老保险、医疗保险等法定社会保险及住房公积金的全覆盖缴纳义务，同步建立基于岗位价值与绩效产出的薪酬动态校准体系，确保劳动报酬分配机制的公平性与竞争性。针对职场平等权保障，公司制定涵盖种族、国籍、性别等八大基准的反歧视管理规程，搭建“招募准入-职业发展-劳动关系解除”全流程人权保障框架，形成员工权益保障体系与企业可持续发展目标的战略协同。

2025 年，公司将持续推动可持续发展，携手更多的客户、员工、股东/投资者、政府与监管机构、供应商、合作伙伴、社区及公众等各方利益相关者，共同打造更加美好的社会和可持续的未来。

六、强化关键少数责任

2024 年，公司及时反馈传递资本市场各项管理要求，全力支持董事、监事、高级管理人员参与监管机构举办的各种线上、线下培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。

2025 年，公司将继续坚持组织“关键少数”参加法律法规、公司治理等方面的培训，提升“关键少数”合规意识和专业素养，不断提升履职能力。同时，进一步优化管理层激励和约束机制，将高管薪酬与上市公司经营效益表现合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，强化经营层与股东的利益共担共享约束。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日